

2019年9月18日から20日まで台北南港展覽館にて開催される「SEMICON Taiwan 2019」に出展します。展示会当日は、新製品ラインアップを展示し、実機によるデモンストレーションも行います。

ダイボンダーの分野においてあらゆるニーズにお応えできるラインナップをご用意しております。

ご来場の際には、是非とも当社ブースにお立ち寄りくださいますよう、お願い申し上げます。

展示会開催中は、下記の製品をご紹介します。

開催期間	2018年9月18日(水)～20日(金) 9:00～17:00 (最終日のみ16:00まで)	
会場	Taipei Nangang Exhibition Center, Taiwan	
出展ブース	TWTC Nangang Hall (4 F) No. L0416 ※ Canon Semiconductor Equipment Taiwan, Inc.ブース内	
交通アクセス	http://www.twtcnangang.com.tw/en/transportation	
出展機種	<p>メモリー用ダイボンダー BESTEM-D531ti</p> 	<p>ワイヤボンディング検査装置 BESTEM-V110</p> 
<p>本展示会・製品に関するお問い合わせ： キヤノンマシナリー株式会社 セミコンシステム事業本部 営業部 電話番号：077-566-1822 FAX番号：077-566-1833 E-Mail：sales-ml@canon-machinery.co.jp</p>		